

이 보고서는 코스닥 기업에 대한 투자정보 확충을 위해 발간한 보고서입니다.

기술분석보고서



YouTube 요약 영상 보러가기

# 하나마이크론(067310)

## 반도체

요약

기업현황

재무분석

주요 변동사항 및 전망



작성기관

(주)NICE디앤비

작성자

박정연 연구원

- 본 보고서는 「코스닥 시장 활성화를 통한 자본시장 혁신방안」의 일환으로 코스닥 기업에 대한 투자정보 확충을 위해, 한국거래소와 한국예탁결제원의 후원을 받아 한국IR협의회가 기술신용 평가기관에 발주하여 작성한 것입니다.
- 본 보고서는 투자 의사결정을 위한 참고용으로만 제공되는 것이므로, 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 보고서를 활용한 어떠한 의사결정에 대해서도 본회와 작성기관은 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 본 보고서는 '20.04.02'에 발간된 동 기업의 기술분석보고서에 대한 연계보고서입니다.
- 본 보고서의 요약영상은 유튜브로도 시청 가능하며, 영상편집 일정에 따라 현재 시점에서 미게재 상태일 수 있습니다.
- 카카오톡에서 “한국IR협의회” 채널을 추가하시면 매주 보고서 발간 소식을 안내 받으실 수 있습니다.
- 본 보고서에 대한 자세한 문의는 작성기관(TEL.02-2122-1300)로 연락하여 주시기 바랍니다.



한국IR협의회

# 하나마이크론(067310)

반도체 패키지 개발 기술을 기반으로 다양한 반도체 칩 부품화 수요에 대응하며 성장

## 기업정보(2022/01/13 기준)

대표자	이동철
설립일자	2001년 08월 23일
상장일자	2005년 10월 11일
기업규모	중견기업
업종분류	전자집적회로 제조업
주요제품	반도체 패키징 및 테스트 등

## 시세정보(2022/01/24 기준)

현재가	18,000원
액면가	500원
시가총액	8,626억 원
발행주식수	47,921,854주
52주 최고가	22,353원
52주 최저가	7,948원
외국인지분율	5.04%
주요주주	
최창호 외 8인	27.92%

## 반도체 패키징 및 테스트 기업

하나마이크론(이하 동사)은 반도체 패키징 및 테스트 사업 등을 영위할 목적으로 2001년 8월 23일에 설립되었다. 동사는 설립 이후 플립칩 패키지, 유연 소자 패키지 등의 핵심 패키지 기술을 개발하여 FCBGA(Flip Chip Ball Grid Array) 등의 다양한 반도체 칩을 부품화하며 지속적으로 성장하고 있다. 2020년 연결재무제표 기준 동사의 매출액은 약 5,394.6억 원이며, 이 중 반도체 칩 부품화 매출액이 2,965.5억 원(55.0%)으로 동사의 주요 매출을 차지한다.

## 전방산업의 성장 촉진요인에 따라 성장하는 OSAT 시장

코로나19, 자율자동차 등의 요인이 반도체 시장의 성장을 촉진함에 따라 주요 반도체 기업들이 전공정/첨단 패키징에 집중하면서 자체적으로 수행하던 후공정 물량을 반도체 패키징, 조립, 테스트 아웃소싱(Outsourced Semiconductor Assembly and Test, 이하 OSAT)에 위탁생산하고 있으며, 반도체 공정이 미세화됨에 따라 불량률을 낮출 수 있는 테스트 공정과 패키징 공정의 중요도가 높아지면서 전문 반도체 패키징 서비스에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있다. 이에 따라, 세계 OSAT 시장도 지속적으로 성장하고 있는 추세이다.

## 사업 강화를 위한 신설법인 설립

동사는 범프사업 전문화를 위해 2021년 1월 하나더블유엘에스를 설립하였으며, 글로벌 자동차용 반도체 1위 기업 N사를 포함한 국내외 웹리스를 고객사를 확보하여 사업을 영위하고 있다. 하나더블유엘에스는 향후 자율주행차 및 전기차의 보편화에 따른 자동차용 반도체의 수요가 증가함에 따라 수혜를 받을 것으로 전망된다. 한편, 브라질 반도체 패키징 및 테스트 사업 강화를 위해 2021년 6월 Hana Electronics Industria E Comercio Ltda를 설립하였으며, 기존 브라질 법인과 함께 브라질 고객사 관리, 반도체 패키징 및 테스트 서비스를 제공할 예정이다.

## 요약 투자지표 (K-IFRS 연결기준)

구분	매출액 (억 원)	증감 (%)	영업이익 (억 원)	이익률 (%)	순이익 (억 원)	이익률 (%)	ROE (%)	ROA (%)	부채비율 (%)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	PBR (배)
2018	4,799.5	31.2	534.2	11.1	216.5	4.5	1.1	3.9	193.3	49	4,800	61.6	0.6
2019	4,982.0	3.8	452.5	9.1	145.1	2.9	-1.7	2.2	198.9	-76	4,252	N/A	1.1
2020	5,394.6	8.3	510.1	9.5	36.3	0.7	-11.8	0.5	210.0	-448	3,644	N/A	2.5

## 기업경쟁력

### 글로벌 OSAT 기업

- Yole Developpement에서 2020년에 조사한 글로벌 OSAT 25위 기업 중 14위에 위치하며, 글로벌 OSAT 상위 기업으로 입지를 굳하고 있음

### 해외법인 보유

- 해외 고객사의 요구사항을 빠르게 반영하기 위한 해외 법인(베트남법인, 브라질법인 등) 보유
  - 브라질 사업 강화를 위해 추가적으로 2021년 6월 Hana Electronics Industria E Comercio Ltda 신설

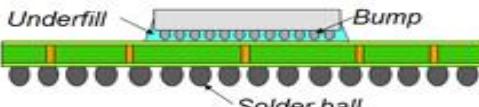
## 핵심기술 및 적용제품

### 동사의 핵심기술

- 반도체 칩 부품화를 위한 플립칩 패키지, 유연 소자 패키지, 웨어퍼레벨 패키지 등 다양한 패키지 기술을 확보
  - 주력기술인 플립칩(Flip Chip) 패키징 기술을 활용하여 FCBGA, FCBGA-H, FCFBGA, FCFBGA CUF 등 다양한 제품군 확보
  - 유연 패키지 기술을 활용해 지문인식센서용 모듈, RF 모듈 등 다양한 제품군 확보

### 동사의 주력제품

#### FCBGA(Flip Chip Ball Grid Array)



## 시장경쟁력

### 세계 OSAT 시장규모 및 성장률

연도	시장규모	성장률
2018년	306.8억 달러	연평균 4.65% ▲
2026년(E)	440.5억 달러	

### 세계 OSAT 산업 동향 및 특징

- 주요 반도체 기업들이 자체적으로 수행하던 후공정 물량을 OSAT에 위탁생산하는 추세
- 반도체 공정 미세화로 불량률을 낮추는 전문 반도체 패키징 서비스에 대한 수요가 지속적으로 증가
- 거대 파운드리, 주요 IC 기판 및 PCB 기판 제조기업들이 진입함에 따라 경쟁이 심화
- 글로벌 상위 25위 OSAT 기업에 대만기업(ASE 등)이 12개, 중국기업(JCET 등)이 3개가 포함되어 있으며, 상기 기업들이 세계 시장의 73% 이상을 점유하며 시장을 선도

## ESG(Environmental, Social and Governance) 활동 현황

**E**  
(환경경영)

- 동사는 환경에 대한 지속적인 관심을 바탕으로 환경영영을 실천하여 ISO 14001(환경경영시스템) 인증을 취득한 바 있음.
- 동사는 환경문제의 중요성을 인식하여 제품 개발 및 생산과정에 국내외 환경 관련 법규를 준수하고 있음.
- 동사는 환경부 주관으로 시작된 생활 속 탈(脫) 플라스틱 생활 습관을 만드는 '고고 챌린지(GOGO Challenge)' 릴레이에 동참하며 근무환경 내에서 환경보호를 위한 노력을 수행하고 있음.

**S**  
(사회책임경영)

- 동사는 모든 구성원이 참여하는 자율안전보건관리 체제를 구축하고, 모든 임직원과 협력 직원들이 안전보건 법규 및 회사 규정을 준수하도록 관리하고 있음.
- 동사는 근로자의 인권이 보장되고 존엄성을 인정받는 사업장을 만들기 위해 노력하고 있으며, 인센티브 제공, 다양한 교육훈련 제공, 웰빙클럽 운영 등 다양한 복지제도를 통해 임직원들의 노고를 격려하고 있음.
- 동사는 전 임직원을 정규직으로 채용하고 있으며, 성별에 따른 고용 평등을 위해 노력하여 2021년 남녀고용평등 우수기업으로 선정되어 국무총리 표창을 받은 바 있음.

**G**  
(기업지배구조)

- 동사는 사외이사를 보유하고 있으며, 경영진과 특수관계인이 아닌 감사 1인을 선임하여 감사의 독립성을 확보하고 있음.
- 동사는 홈페이지에 감사보고서와 사업보고서를 공개하여 기업공시제도 의무를 준수하고 있으며, 배당급 지급 제도, 전자투표제 등을 도입하여 주주친화 활동을 시행 중임.

NICE디앤비의 ESG 평가항목 중, 기업의 ESG 수준을 간접적으로 파악할 수 있는 항목에 대한 설문조사를 통해 활동 현황을 구성

# I. 기업현황

## 반도체 패키징 및 테스트 기업

동사는 반도체 패키징 개발 기술을 바탕으로 플립칩 패키지(Flip Chip Package), 웨이퍼레벨 패키지(Wafer Level Package, WLP), 멀티칩 패키지(Multichip Package, MCP), 플렉시블 패키지(Flexible Package) 기술을 확보하며 다양한 반도체 칩 부품화 수요에 대응하고 있다.

### ■ 기업개요

동사는 2001년 8월 설립된 반도체 패키징 및 테스트 기업으로, 2003년 6월 성진전자와 합병하며 반도체 조립, 테스트 일괄 생산체계를 구축하였다. 동사는 2002년 FBGA(Fing-pitch Ball Grid Array) 패키지 기술을 개발하며 성장의 토대를 마련한 후, 삼성전자, SK하이닉스 등 국내외 고객사들과의 파트너십 계약을 체결하며 지속적인 성장을 거듭하였다. 이를 통해, 동사는 2005년 7월 Korea Fast Technology 50기업에 선정되고, 2005년 10월 코스닥 시장에 상장되었다. 이후, 동사는 반도체 기술 트렌드 변화에 따라 연구개발을 지속하며 2012년 6월 유연 실리콘 메모리 패키징 공정기술을 개발하고, 2015년 7월 플렉시블 메디컬 디바이스용 모듈을 양산하였으며, 2018년 6월 3차원 플렉시블 반도체 패키징 상용화 기술을 확보하여 플렉시블 제품 수요에 대응하고 있다.

### ■ 주요주주 및 계열회사

네이버 금융(2022.01.13) 기준, 동사의 최대주주는 16.58%의 지분을 보유한 회장 최창호이며, 최창호는 설립 이후부터 2017년 3월까지 한호창과 각자대표 체제로 경영업무 전반을 총괄하였다. 동사의 현 대표이사 이동철은 2019년 3월 취임하였다.

동사는 하나머티리얼즈, 이노메이트, 이피웍스, 하나마이크론 태양광, 하나더블유엘에스, HT MICRON SEMI CONDUCTORES S.A.(브라질), HANA Micron America Inc(미국), AniTrace Inc(미국), HANA INNOSYS LATIN AMERICA, LIMITED(브라질), HANA Micron Vietnam Co., Ltd(베트남), Hana Electronics Industria E Comercio Ltda(브라질), HANA LATIN AMERICA, Ltda.(브라질), Hana Micron Vina Co., Ltd(베트남) 등 국내외 총 13개의 계열회사를 보유하고 있으며, 이 중 주요 종속회사는 Hana Micron Vina Co., Ltd(베트남), HT MICRON SEMICONDUCTORES S.A.(브라질), 하나머티리얼즈이다.

[표 1] 동사 주요 종속회사			
사업 부문	구분	회사명	사업내용
반도체 제조	지배회사	하나마이크론(동사)	반도체 패키징 & 테스트
	종속회사	HT MICRON SEMICONDUCTORES S.A.	반도체 패키징 & 테스트
	종속회사	Hana Micron Vina Co.,Ltd	반도체 패키징 & 테스트
반도체 재료	종속회사	하나머티리얼즈	반도체 식각장비의 Silicon parts 등

\*출처: 동사 분기보고서(2020.09)

## ■ 주 사업영역 관련 핵심기술 및 주요제품

동사는 현재 지배관계에 의해 주요 종속회사의 사업을 사업부문에 포함하고 있으며, 동사의 주요 사업부문은 반도체 제조부문과 반도체 재료부문으로 구분되어 있다. 그 중 핵심사업에 해당하는 반도체 제조부문은 세부적으로 패키징을 통한 반도체 칩 부품화 및 기타로 각각 구성된다. 반도체 제조부문은 반도체 제조공정 중 후공정에 속하며, 반도체 패키징을 통해 미세 전기 회로가 집적된 반도체 칩을 외부 영향으로부터 보호할 수 있도록 밀봉하여 포장하는 동시에 외부와의 전기적 연결 및 열 방출 경로를 확보하여 완제품을 제조하는 부문으로, 반도체 내부의 집적회로와 함께 최종적인 제품 성능을 향상시키고 있다.

동사는 반도체 패키징 및 테스트 전반에 대한 핵심기술을 확보하고 있으며, 이를 통해 플립칩 패키지, 웨이퍼레벨 패키지, 멀티칩 패키지, 플렉시블 패키지를 포함하는 다양한 패키지 기술을 개발하여 반도체 칩을 부품화하며 성장하고 있다.

한편, 동사는 신성장동력 확보의 일환으로 반도체 재료부문에 실리콘 부품(Si-Parts) 외 파인세라믹스 부품(SiC-Parts) 관련사업을 추가하였다. 파인세라믹스 부품은 실리콘 부품과 동일하게 반도체 핵심공정인 예칭(식각) 공정에 사용되고 있다. 현재, 반도체 공정은 미세화와 Step 수의 증가가 진행될 수록 고주파 플라즈마를 견뎌야하는 공정시간이 길어지고 있어 고온 물성이 우수할 뿐만 아니라 내산화성, 내마모성, 내부식성 및 열충격 저항성이 우수한 파인세라믹스 부품의 채택이 증가하고 있다. 이에, 동사는 종속회사인 하나머티리얼즈를 통해 반도체 공정용 CVD SiC Parts를 개발하였으며, CVD SiC Ring 양산을 통한 매출 및 수익성 증대를 기대하고 있다.

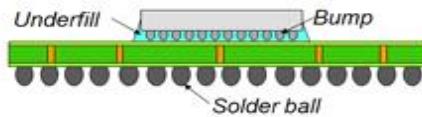
## ■ 매출실적 현황

동사의 사업보고서(2020.12)에 따르면, 동사의 매출(연결기준)은 반도체 칩 부품화 2,965.5억 원(55.0%), 반도체 공정 소모품 1,895.6억 원(35.2%), 기타 412.2억 원(7.6%), 특수가스 외 121.3억 원(2.2%)으로 구성되어 있으며, 반도체 칩 부품화의 매출 비중이 가장 높은 것을 확인할 수 있다.

동사의 사업이 속하는 반도체 패키징 산업은 전방산업인 반도체 산업의 경기에 영향을 받는 산업이다. 최근 반도체 산업은 반도체 공정이 미세화됨에 따라, 불량률을 낮출 수 있는 테스트 공정과 반도체 회로의 연결 및 보호를 비롯하여 생산성과 효율성 등의 성능과 경제성을 보완해줄 수 있는 패키징 공정의 중요도가 높아지고 있다. 이에 따라, OSAT 기업들의 수주량이 급격히 증가하는 추세이며, 국내 주요 반도체 업체들이 전력반도체, 이미지센서 등의 시스템반도체의 물량과 종류를 늘려감에 따라 OSAT 기업 매출에도 긍정적인 영향을 주고 있다. 이러한 흐름에 따라, 동사는 최근 3년간 지속적으로 성장한 2018년 4,799.5억 원, 2019년 4,982.0억 원, 2020년 5,394.6억 원의 매출실적을 기록하였다.

[그림 1] 동사 주요제품

FCBGA

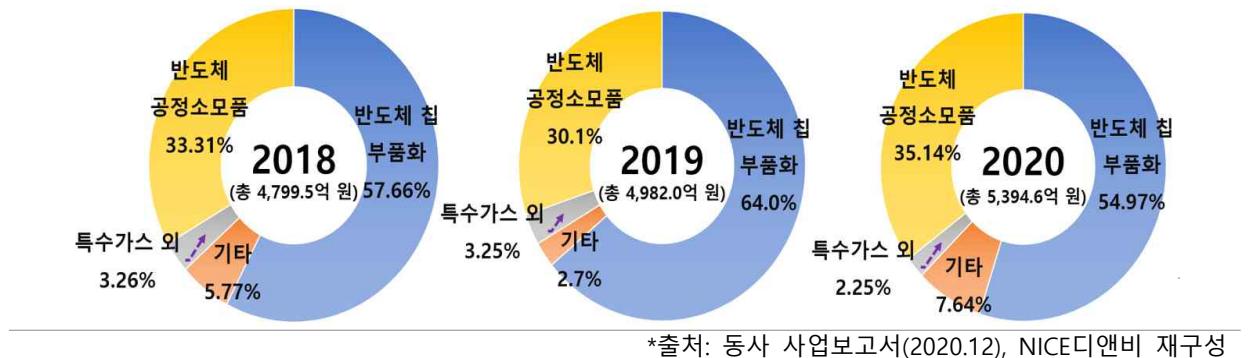


Fingerprint Sensor for Smart Cards



\*출처: 동사 홈페이지

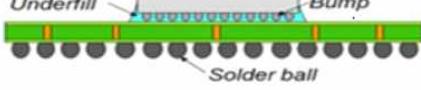
[그림 2] 동사의 3개년 매출액 추이



## ■ 동사의 주력 패키징 기술은 플립칩 패키징 기술

동사의 다양한 반도체 패키징 기술 중 주력 패키징 기술은 플립칩 패키징 기술이다. 플립칩 패키징은 FCB(Flip Chip Bonding)로 불리며, 칩을 뒤집어서 기판 및 메인보드에 직접 실장하는 패키지 형태이다. 이 패키지는 전기적인 배선이 칩의 전면 미세돌기형태의 전극(Bump)을 통해 이루어지기 때문에 와이어 본딩 루프의 높이가 없어 좁은 면적으로 칩 실장 밀도를 높일 수 있어 와이어 본딩 방식의 패키지에 비해 크기가 매우 작고, 배선 수가 많아질수록 배선을 하나씩 연결하는 와이어 본딩에 비해 공정비용이 크게 절감되는 효과가 있다. 또한, 플립칩 본딩 방식은 전체 표면을 전기적 연결 통로로 사용할 수 있어 입출력 단자의 수를 늘릴 수 있는 장점이 있다. 이에 따라, DRAM 등의 메모리 소자와 Flash 메모리의 패키지로 사용된다. 동사의 플립칩 패키지 기술 중 내부 연결에 사용되는 범프는 패키지 사이즈의 경박단소화 및 고용량, 고집적화 등의 기술 요구사항이 증가함에 따라 지속적으로 기술발전이 이루어지고 있다. 이러한 기술을 기반으로 동사는 FCBGA, FCBGA-H, FCFBGA, FCFBGA CUF 등의 다양한 제품을 제작하고 있다.

[표 2] 동사의 플립칩(Flip Chip) 패키징 기술을 적용하여 제작된 제품

제품	구성	특징
FCBGA(Flip Chip Ball Grid Array)		<ul style="list-style-type: none"> <li>고주파 응용 분야에서 와이어 본드 유형 BGA 패키지보다 우수한 전기적 성능을 제공함.</li> </ul>

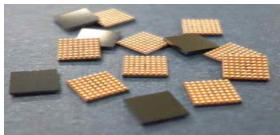
\*출처: 동사 홈페이지, NICE디앤비 재구성

## ■ 급속 충전용 칩에 활용되는 웨이퍼레벨패키지(WLP) 기술을 보유

동사는 급속 충전용 칩이 안정적으로 구현할 수 있게 반도체 칩 배선 두께를 기준보다 4배 늘린 웨이퍼레벨패키지 기술을 확보하고 있다. 웨이퍼레벨패키지는 웨이퍼 칩 공정이 끝난 웨이퍼를 일일이 자르지 않고 한 번에 패키징하는 기술로 웨이퍼를 그대로 두고 반도체 회로와 외부 모듈을 이어줄 전극을 형성하고 있으며, 패키지 공정 끝에 반도체 칩 하나를 형성하는 디(Die)를 하나하나 잘라내 모듈에 부착하고 있다. 웨이퍼레벨패키지는 인쇄회로기판과 반도

체 사이에 들어가는 보조기판이 필요하지 않아 반도체 칩의 크기를 줄일 수 있고, 기존에 반도체 다이(Die)별로 잘라내서 패키징 공정을 진행할 때보다 제조 원가를 줄일 수 있는 장점을 보유하고 있다. 동사는 자체적으로 개발한 HANA's Thick RDL(레이어 재배치) WLP 기술을 활용해 5G 스마트폰 급속충전 칩을 패키징하고 있다. 동사의 HANA's Thick RDL(레이어 재배치) WLP 기술은 반도체 칩 배선 두께를 기존( $5\mu\text{m}$ )보다 4배 늘린( $20\mu\text{m}$ ) 배선을 사용하고 있어, 배선 두께가 굽어지면서 급속 충전을 통해 늘어나는 전류량에도 전기적 저항을 최소화하여 급속 충전용 칩을 안정적으로 구현할 수 있게 구성하였다.

[표 3] 웨이퍼레벨패키지(WLP) 기술을 적용한 제품

제품	특징
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 배선 두께가 굽어지면서 급속 충전을 통해 늘어나는 전류량에도 전기적 저항을 최소화하여 급속 충전용 칩을 안정적으로 구현</li> </ul>

\*출처: 동사 홈페이지, NICE디앤비 재구성

### ■ 유연 패키지 기술(Flexible Package)을 보유

동사는 자유자재로 휘어지는 유연 반도체 패키지 기술인 하나플렉스 기술을 보유하고 있다. 기존 실리콘 반도체 소자는 두께가  $80\mu\text{m}$  이상일 경우는 딱딱한 성질을 가지고 있고, 그 이하가 되면 유연한 특성을 가지게 된다. 동사는 하나플렉스 기술은 실리콘 소자를  $80\mu\text{m}$  이하로 얇게 한 후 유연한 기판에 접합시키고 소자 간 연결을 통해 유연한 반도체 소자를 제조하는 기술이다. 이러한 과정을 통해 자유자재로 휘어지며, 박형 및 기계적 성질이 우수한 메모리를 만들어낼 수 있으며, 동사의 기술은 의류 등 웨어러블 제품에 적용될 수 있다. 동사는 2018년에 지문인식센서 전문기업 스웨덴 핑거프린터카드(FPC)와 손잡고 FPC의 센서에 하나플렉스 기술을 이용해 스마트카드에 탑재 가능한 지문인식 모듈 개발을 완료한 바 있다.

[표 4] 유연 패키지 기술을 적용한 제품

제품	특징
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 얇은 두께(<math>300\mu\text{m}</math>)의 스마트카드에 적용 가능</li> </ul>

\*출처: 동사 홈페이지, NICE디앤비 재구성

### ■ 연구개발 활동

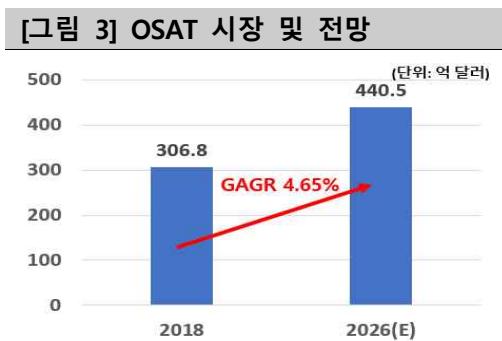
동사는 2002년 공인 기업부설연구소를 설립하고, 제품 성능향상을 위한 FCBGA-HS type, 3D FOWLP 기술, 치과용 Bio intra-oral flexible sensor package 기술, 지문인식 센서 패키지 기술, Thick RDL 기술, 3차원 플렉서블 반도체 패키징 기술 등의 다양한 반도체 패키지 기술을 개발하고 있다. 또한, 기술보호를 위해 ‘이미지 센서 패키지, 모듈, 및 그 제조 방법’, ‘반도체 후공정 시스템에서 이기종 설비 간 데이터 연동을 위한 방법 및 장치’, ‘반도체 후 공정용 분석결과 피드백을 수행하기 위한 방법 및 장치’ 등 다수의 특허권을 확보하고 있다.

## ■ 반도체 산업의 성장 촉진요인에 따라 성장하는 OSAT 시장

반도체 산업의 기업형태는 크게 종합반도체 기업(Integrated device manufacturer, 이하 IDM), 팹리스(Fabless), 디자인하우스, 파운드리(Foundry), 패키징·테스트(OSAT)로 구분된다. 이 중 동사는 IDM 및 파운드리에서 생산한 반도체 소자의 후공정을 담당하는 OSAT 기업에 속한다.

일반적으로 반도체 제조공정은 웨이퍼에 회로를 인쇄하는 전공정과 개별칩으로 분리, 조립, 패키징 및 테스트를 수행하는 후공정으로 구분된다. 이때, 데이터를 기억 및 저장하는 회로장치인 메모리 반도체는 소품종 대량생산이 가능하고 기술력 및 양산 능력이 중요하여, IDM이 대부분의 공정을 담당하고 일부 물량만 OSAT 기업들에게 넘긴다. 이에 비해, 연산과 정보 처리를 담당하는 회로장치인 비메모리 반도체는 정교하고 다양한 설계를 바탕으로 단품종 소량생산을 하는 경우가 대부분이므로 설계만 전문으로 하는 팹리스와 생산만 담당하는 파운드리에서 전공정을 담당하고, OSAT 기업이 후공정을 담당하여 제품을 생산하고 있다.

Verified Market Research(2021)에 따르면, OSAT 시장은 2018년 306.8억 달러에서 연평균 4.65% 성장하여, 2026년에 440.5억 달러 규모를 형성할 것으로 전망된다. 이러한 흐름은 크게 2가지 요인이 작용한 것으로 판단된다. 먼저, 코로나19가 전세계적으로 디지털화를 가속화해 클라우드 서비스, 서버, 헬스케어, 스마트기기 등에 사용되는 반도체 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 자율주행 시대를 준비하기 위한 첨단운전자보조시스템 등 각종 주행, 구동 장치



\*출처: Verified Market Research(2021), NICE디앤비 재구성

기술개발을 통해 차량용 반도체 시장의 성장을 촉진함으로써 세계 반도체 시장이 지속적으로 성장함에 따라 IDM이 전공정/첨단 패키징에 집중하고 자체적으로 수행하던 후공정 물량을 OSAT에 위탁 생산함에 따른 것으로 판단된다. 두번째로는 반도체 공정이 미세화됨에 따라, 불량률을 낮출 수 있는 테스트 공정과 반도체 회로의 연결 및 보호를 비롯하여 생산성과 효율성 등의 성능과 경제성을 보완해줄 수 있는 패키징 공정의 중요도가 높아지면서 전문 반도체 패키징 서비스에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있는 추세에 따른 것으로 판단된다.

## ■ 반도체 후공정 산업에서 선도적 위치를 유지하고 있는 대만기업 및 중국기업

반도체 후공정은 반도체 칩을 외부로부터 보호할 수 있도록 밀봉하여 포장하는 동시에 외부와의 전기적 연결 및 열 방출 경로를 확보하여 개별 칩 형태의 완제품으로 제작하고 테스트하는 공정을 의미하며, 기계, 전기, 전자 재료 등 다양한 분야가 융합된 전문기술을 사용하고 있다. 따라서, 반도체 후공정 산업은 각종 공정장비의 대규모 설비투자를 요구하는 장치산업, 기술집약적 산업의 특징을 가지고 있다. 또한, 축적된 경험이 필요하므로 비교적 진입장벽이 높으며, 주문 제작 방식으로 이루어지기 때문에 IDM/팹리스/파운더리 기업과의 협력관계가 필수인 산업이다. 이에 따라, 반도체 후공정 산업은 반도체 패키징 및 테스트관련 기반 기술력을 갖춘 대만 및 중국기업들이 선도하고 있다.

Yole Developpement(2020)에 따르면, 글로벌 상위 25위 OSAT 기업에 대만기업(ASE 등)이 12개, 중국기업(JCET 등)이 3개가 포함되어 있으며, 상기 기업들이 세계 시장의 73% 이상을 점유하며 시장을 선도하고 있다. 특히, ASE의 경우, 2018년 글로벌 OSAT 4위 기업이었던 SPIL을 인수하며 글로벌 OSAT 2위 기업인 Amkor(미국)와 2배 이상의 매출격차를 보이고 있다. 반면, 우리나라는 글로벌 상위 25위 OSAT 기업에 SFA반도체, 동사, 네페스 총 3개의 기업만이 존재하며, 글로벌 상위 25위 OSAT 기업 중 점유율은 약 3.2% 수준이다.

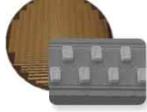
한편, 전통적인 OSAT, IDM 기업의 영역이었던 반도체 패키징 산업에 거대 파운드리, 주요 IC 기판 및 PCB 기판 제조기업들이 진입함에 따라 경쟁이 심화되고 있다. 특히, TSMC(대만)의 경우, 파운드리 기업임에도 불구하고 패키징 분야 기술력을 확보하여 반도체 패키징뿐 아니라 어셈블리·테스트 분야 외주 파트너의 공급망을 관리하는 등 고객사에게 반도체 후공정 분야의 Turn-key 서비스를 제공하며 시장점유율을 확대하고 있다. 이러한 위기를 극복하기 위해, 기존 OSAT 기업들은 패키징 분야뿐만 아니라 테스트 영역에 대한 투자를 확대함으로써 Turn-key 사업형태를 강화하는 추세이다.

## ■ 정부지원 정책 및 경쟁사

우리나라는 메모리반도체 분야 세계 1·2위 IDM 기업을 보유하고 있으나, 패키지 기술을 포함한 시스템반도체 분야 산업경쟁력은 다소 열세한 수준이다. 이에, 우리나라는 메모리반도체 중심의 산업구조를 탈피하고 시스템반도체의 경쟁력을 강화하여 종합반도체 강국으로 거듭나기 위해 시스템반도체 분야에 대한 대대적인 지원정책이 발표되고 있다. 특히, 동사의 사업이 속하는 패키징 분야 정부 R&D 투자액이 꾸준히 증가하는 추세로 동사의 영업활동에 정책적인 부정적 영향은 없는 것으로 판단된다. 다만, 반도체 기술의 발전속도에 따라 패키징 기술의 다변화와 고도화가 필요한 상황으로, 패키징 기술개발을 위한 검증 인프라 및 시제품제작 등을 위한 적극적인 특화 사업 추진이 필요해 보인다.

한편, 동사의 국내 경쟁기업으로는 SFA반도체, 네페스, 시그네틱스 등이 있으며, 각 회사의 2020년 매출액은 동사가 5,394.6억 원, SFA반도체가 5,730.8억 원, 네페스가 3,435.6억 원, 시그네틱스가 2,015.4억 원으로 SFA반도체가 가장 높은 매출액을 시현한 것으로 확인된다.

[표 5] 국내 반도체 패키징 기업

기업명	주요제품	개발내용	2020년 매출액
SFA반도체		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Flip Chip New PKG, Wire Bonding New PKG, SiP Hybrid FC PKG 등 개발함.</li> <li>● 첨단 패키지 시장에 적극적인 대응을 통해 안정적인 성장과 수익성 창출 기대 중임.</li> </ul>	5,730.8억 원
네페스		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 경박단소한 비메모리 반도체 패키지를 실현하게 하는 핵심기술을 기반으로 WLP 및 FOWLP(Fan-Out Wafer Level Package) 제품군을 갖추고 있음.</li> </ul>	3,435.6억 원
시그네틱스		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Fingerprint sensor 패키지 기술개발을 통해 대량 물량을 수주함.</li> <li>● O-Film, Egistec, Q-tech, Dreamtech, FPC 등 지문인식 고객 수주 확대를 진행함.</li> </ul>	2,015.4억 원

\*출처: 각 기업의 홈페이지(2021) 및 사업보고서(2020.12), NICE디앤비 재구성

## ■ SWOT 분석

[그림 4] SWOT 분석



## ■ 동사의 ESG 활동

동사는 EHS(Environment, Health, Safety)경영시스템을 구축하고 환경, 보건, 안전에 대한 사회적 책임을 다하며, 지속적이고 혁신적인 환경안전보건 문화를 정착하기 위해 노력하고 있다. 이를 위해, 동사는 전자산업 또는 전자제품이 주요 구성요소인 산업에서 안전한 작업환경을 구축하고, 근로자에 대한 존중과 존엄성을 보장하며, 환경친화적이고 윤리적인 기업 운영을 하도록 제정한 RBA(Responsible Business Alliance) 행동규범에 기반을 둔 하나마이크론 행동규범을 규정하고 모든 임직원들이 행동규범을 준수하도록 관리하고 있다.



동사는 환경(E) 부문에서 생활 속 탈(脫) 플라스틱 생활 습관을 만드는 ‘고고 챌린지(GOGO Challenge)’ 릴레이(환경부 주관)에 동참하고 있다. 이를 위해, 동사는 사내에서 임직원들이 일회용품이 아닌 텀블러 등 친환경 제품을 사용하도록 독려하고 있으며, 태양광 패널 설치, 노후 장비를 고효율 장비로 교체 등의 자원 및 에너지 사용 효율화를 통해 온실가스 배출량 감축 및 폐기물 배출을 최소화하고 있다. 또한, 모든 구성원이 환경영향 방침을 이해하고 준수할 수 있도록 지속적인 교육을 실시하고 있으며, 온실가스 목표 관리업체 및 온실가스 배출권 할당대상 업체로 지정되어 온실가스 배출량 및 에너지 사용량을 정부에 보고하고 있다. 이외에도, 동사는 제품 개발 및 생산과정에서 국내외 환경관련 법규를 준수하고 있으며, 제품의 전 과정에 걸쳐 환경오염 예방과 개선활동을 지속적으로 추진하여 친환경 사업장을 구축하고 있다. 이러한 노력을 통해, 동사는 환경영영시스템(ISO14001) 인증을 취득한 바 있다.



동사는 사회(S) 부문에서 모든 구성원이 참여하는 자율안전보건관리 체제를 구축하고, 모든 임직원과 협력 직원들이 안전보건 법규 및 회사 규정을 준수하도록 관리하고 있다. 또한, 동사는 안전보건관리시스템의 효율적 운영을 위해 사전 안전검토제도를 확대하여 정기적으로 유해, 위험 요소를 평가하고 개선하여 안전한 근무환경을 조성하고 있다. 더불어, 동사는 고객의 요구에 부합하는 최고의 제품과 서비스를 제공하기 위해 체계적인 품질관리 시스템을 구축하여 지속적인 개선 활동을 진행하고 있다. 이러한 노력을 통해, 동사는 ISO9001(품질경영시스템), ISO45001(안전보건경영시스템), IATF16949(자동차품질경영시스템) 등의 품질인증을 취득한 바 있다.

동사는 근로자의 인권이 보장되고 존엄성을 인정받는 사업장을 만들기 위해 노동인권을 강화하고 있다. 동사는 최저임금, 초과근무수당 및 법정수당 관련 법률을 비롯해 모든 급여 관련 법률을 준수하고 있으며, 정계 조치로 급여 삭감은 허용하지 않고 있다. 또한, 동사는 성과 관리 인센티브 제도를 운영하여 업무 실적을 평가하고 있으며, 이를 통해 목표 관리 결과와 함께 인센티브 제공 및 승진 등 직원들의 노력에 따른 합리적 보상을 보장하고 있다. 또한, 다양한 교육 훈련(사내대학 등)을 통해 직원 개개인의 자기계발과 자질 향상을 지원한다. 이 밖에 임직원들의 건강을 위한 웰빙클럽(헬스, 수영, 골프 등) 및 사내 건강관리실 운영과 장거리 거주자들을 위한 기숙사 및 통근버스 제공, 자녀 학자금 지원, 사내 친목을 위한 동호회를 운영하고 있으며 휴양시설 지원, 할인가맹점 운영 등을 통해 직원들의 노고를 격려하고 있다.

동사는 사업의 이익과 성장만 추구하는 것이 아니라, 지역사회와 소외계층을 위한 공헌 활동을 꾸준히 이어가고 있다. 동사는 사회적 약자인 장애인의 고용과 함께 반도체 전문가로 양성하는 직업능력개발 사업에 직접 참여하고 있으며, 이를 통해 장애인 고용우수 사업장으로 대통령상을 수상한 바 있다. 또한, 사내 봉사단을 운영하여 정기적으로 지역사회 취약계층, 복지시설 등을 방문하여 봉사활동을 진행하고 있으며, 임직원들의 기부를 통해 봉사기금을 적립하고 정기적으로 지역사회 소외계층을 위해 기부하고 있다. 일례로, 동사는 2021년에 창립 20주년을 맞아 임직원들이 함께 견주 기부 캠페인에 참여해 목표걸음 달성을 금액 1000만원을 모아 충남사회복지공동모금회를 통해 도내 취약계층 지원을 위해 기부한 바 있다. 또한, 사업장 주변과 관내 하천 생태계 복원 및 수질 보전을 위한 환경정화 캠페인을 진행하는 등 기업의 사회적 책임에 앞장서기 위해 노력하고 있다.

동사의 분기보고서(2021.09)에 의하면, 동사는 전 직원을 정규직으로 채용하고 있으며, 여성 근로자의 비율이 약 44.6%으로 동사가 속한 기계 및 장비 제조업 산업의 여성 고용비율 평균인 13.9%(2020년도 산업별 여성고율비율, 고용노동부)를 상회하고 있다. 또한, 동사는 남성 대비 여성 근로자의 임금 수준이 약 82.6%로 산업평균인 73.4%를 상회하고 있는 수준으로 동사는 성별에 따른 고용 평등을 실천하고 있다. 또한, 동사는 경력단절 여성을 매년 채용하고 있으며, 여성을 관리자로 선임하고 출산과 동시에 육아휴직을 자동 사용하게 하는 등 모성보호 제도를 적정 운영하고 남성 육아휴직 제도를 권장하는 등 일·가정 양립을 적정 운영하고 있다. 이를 통해, 동사는 고용노동부로부터 여성 고용 개선 실적, 모성보호 제도, 일·가정 양립 지원, 능력 개발의 양성평등에 대한 실적을 높게 평가받아 2021년 남녀고용평등 우수기업으로 선정되어 국무총리 표창을 받은 바 있다.

[표 6] 동사 근로자의 정규직 수 및 근속연수

성별	직원수(명)			평균근속연수(년)		1인당 연평균 급여액(백만원)	
	정규직	기간제 근로자	합계	동사	동 산업	동사	동 산업
남	396	-	396	7.1	6.9	46	47
여	319	-	319	5.3	6.0	38	33
합계	715	-	715	-	-	-	-

\*출처: 고용노동부 「고용형태별근로실태조사」 보고서(2021.02), 동사 분기보고서(2021.09), NICE디앤비 재구성



지배구조(G) 부문에서 경영활동의 규범적 기준을 사회의 윤리적 가치 체계에 두는 윤리경영을 경영이념으로 삼고 있다. 이를 위해, 동사는 윤리경영을 위한 전담조직을 보유하고 매년 전 직원을 대상으로 성희롱 방지 교육, 직장 내 괴롭힘 방지 교육, 보안유지 서약서 등의 윤리 교육을 실시하고 있으며, 개인보호 및 정보보호(정보보안) 정책을 수립하고 시행 중이다. 동사는 소비자에 대한 공정거래원칙을 공개하고 있으며, 내/외부 이해관계자 간의 투명성, 기업 내/외부 거래의 공정성, 기업활동의 건전성에 대한 구체적인 윤리 강령을 정립하고 이를 바탕으로 이해관계자, 환경, 시장을 보호하며 사회적 책임을 다하고 있다.

동사 분기보고서(2021.09)에 따르면 동사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명으로 구성되어 있으며, 특수관계인이 아닌 주주총회 결의에 의해 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있다. 동사는 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 별도로 구성되어 있지 않으나, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있도록 회사 정관에 감사규정을 정립하여 권한 및 행사절차를 명시하고 있다. 한편, 동사의 최대주주는 최창호이며 16.58%의 지분을 보유하고 있다. 동사는 홈페이지에 감사보고서와 사업보고서를 공개하여 상장기업으로서의 기업공시제도 의무를 어느 정도 준수하고 있는 것으로 확인된다. 이외에도, 동사는 배당금 제도 및 전자투표제를 도입하여 시행하는 등 주주친화 활동을 수행하고 있는 것으로 확인된다.

## II. 재무분석

### 2019년과 2020년 매출실적이 큰 폭으로 하락하였으나, 2021년 실적 반등에 성공

코로나19 확산으로 인한 전방 고객사의 시설투자 감소 등으로 동사의 최근 2개년 매출외형이 큰 폭으로 감소하였다. 2021년 3/4분기 고객사 설비 투자 일부 회복 등으로 누적 매출액이 2020년 총매출액을 상회하며 외형 반등에 성공하였다.

#### ■ 반도체 패키징 및 테스트를 주요 사업으로 전개

동사는 반도체 패키징 및 테스트를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 사업분야는 크게 동사의 주력사업인 반도체 제조부문(반도체 칩 부품화 및 기타)과 종속회사인 하나미티리얼즈의 주력사업인 반도체 재료부문(반도체 공정 소모품 및 특수ガ스)으로 구분된다. 반도체 제조부문에서는 반도체 패키징 및 테스트 사업을, 반도체 재료부문에서는 반도체 식각장비용 실리콘 파트(부품)를 공급하는 가운데, 2020년 연결기준 부문별 매출 비중은 반도체 칩 부품화 2,965.5억 원(55.0%), 반도체 공정 소모품 1,895.6억 원(35.2%), 기타 412.2억 원(7.6%), 특수ガ스 외 121.3억 원(2.2%)를 각각 차지하였다.

#### ■ 최근 3개년 매출 증가세 및 2021년에도 매출 확대 지속

업황호조 및 고객수요 증대에 힘입어 2018년 4,799.5억 원(+31.2% YoY)의 매출액을 기록하였으며, 이후에도 2019년 4,982.0억 원(+3.8% YoY), 2020년 5,394.6억 원(+8.3% YoY)을 기록하며, 매출 외형은 점진적으로 증가세를 유지하였다. 이후, 모바일 D램 수요 상승 등 메모리 업황 개선에 따라 반도체 제조부문과 반도체 재료부문에서 2021년 3분기 누적 매출액은 전년 동기 대비 각각 16.3%, 30.1% 증가하는 등 전반적인 매출 확대에 힘입어 총 4,737.3억 원의 매출액을 시현하였으며, 이는 전년 동기 대비 21.5% 증가한 수준이다. 이러한 전방산업 호조를 바탕으로 2021년 결산 시, 전년 대비 매출 확대 가능성성이 높을 것으로 전망된다.

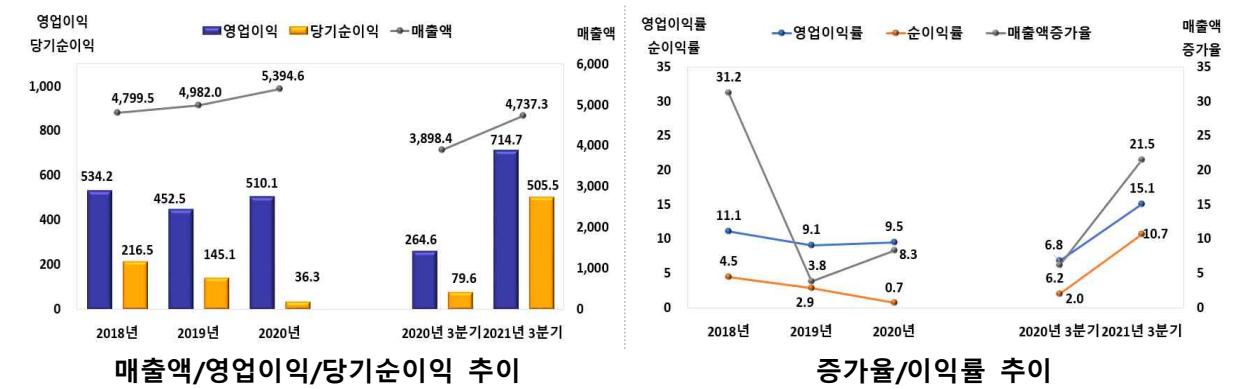
#### ■ 최근 3개년간 전체 수익성 저하 추이, 2021년 수익성 반등

2020년 매출 증가에 따른 고정성 경비 부담 완화로 매출액영업이익률이 전년 9.1%에서 9.5%로 상승하며 영업수익성은 소폭 개선되었다. 그러나, 외환차손 146.4억 원, 외화환산손실 156.4억 원과 더불어 동면사업장 폐쇄 및 가스사업 매각결정에 따른 매각예정자산처분손실 51.1억 원 등의 영업외비용 발생으로 매출액순이익률은 전년 2.9% 대비 크게 하락한 0.7%를 기록하는데 그쳤다.

패키징 사업 대비 별도의 재료비 등이 발생하지 않는 테스트 사업의 수익성이 양호한 가운데, 테스트 사업 가동률이 2021년 8월부터 70% 이상으로 회복된 것에 기인하여 2021년 3분기 기준 매출액영업이익률이 15.1%로 전년 동기 6.8% 대비 크게 상향되었다. 한편, 자산외형 대비 과중한 차입규모에 따른 금융비용과 더불어 법인세비용 등으로 인해 매출액순이익률은 매출액영업이익률 대비 4.4%p 낮은 10.7%를 기록하는데 그쳤으나, 여전히 두자리수의 양호한 수치를 시현하였다.

[그림 5] 동사 연간 및 3분기(누적) 요약 포괄손익계산서 분석

(단위: 억 원, %, K-IFRS 연결기준)



\*출처: 동사 사업보고서(2020.12) 및 분기보고서(2021.09), NICE디앤비 재구성

## ■ 최근 3개년 과중한 차입에 따른 열위한 재무구조 지속, 2021년 재무안정성 개선

2020년 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본은 1,378.9억 원으로 전년 1,449.6억 원 대비 4.9% 감소함에 불구하고, 비지배지분이 1,088.5억 원으로 전년 915.0억 원 대비 19.0% 증가하여 전체 자기자본은 확충되었다. 그러나, 3D 낸드플래시 메모리와 지문인식 패키징 관련 설비 투자 및 공격적인 CAPA 증설 영향으로 차입금 규모가 지속적으로 확대되는 모습을 보인 가운데, 외형대비 절반이상을 상회하는 차입 부담 지속에 기인하여 2020년 부채비율 210.0%, 차입금의존도 55.8%를 기록하며, 전반적인 재무구조는 전년에 이어 제한적인 수준을 지속하였다.

다만, 2021년 3분기 말 기준, 주식매수선택권 행사에 따른 자본금 증자와 이에 따른 주식발행초과금 발생 등으로 자기자본이 확대되면서 부채비율이 전년 말 210.0%에서 180.3%로 하락하는 등 재무구조가 개선되었다. 또한, 2021년 3분기 말 기준 현금/현금성자산은 1,103.5억 원으로 단기차입금에 미치지 못하고 있으나, 제공된 담보(장부가액 기준 1,917.0억 원의 토지 및 건물)과 코스닥 상장사로서의 자본시장 접근성 등을 감안하면 유동성대응능력은 양호한 수준으로 판단된다.

[그림 6] 동사 연간 및 3분기(누적) 요약 재무상태표 분석

(단위: 억 원, %, K-IFRS 연결기준)



\*출처: 동사 사업보고서(2020.12) 및 분기보고서(2021.09), NICE디앤비 재구성

[표 7] 동사 연간 및 3분기(누적) 요약 재무제표

(단위: 억 원, K-IFRS 연결기준)

항목	2018년	2019년	2020년	2020년 3분기	2021년 3분기
<b>매출액</b>	4,799.5	4,982.0	5,394.6	3,898.4	4,737.3
<b>매출액증가율(%)</b>	31.2	3.8	8.3	6.2	21.5
<b>영업이익</b>	534.2	452.5	510.1	264.6	714.7
<b>영업이익률(%)</b>	11.1	9.1	9.5	6.8	15.1
<b>순이익</b>	216.5	145.1	36.3	79.6	505.5
<b>순이익률(%)</b>	4.5	2.9	0.7	2.0	10.7
<b>부채총계</b>	3,986.5	4,702.4	5,180.9	5,591.5	5,490.9
<b>자본총계</b>	2,062.5	2,364.6	2,467.4	2,359.1	3,045.0
<b>총자산</b>	6,049.0	7,067.0	7,648.3	7,950.6	8,535.9
<b>유동비율(%)</b>	44.1	67.1	73.1	72.1	98.7
<b>부채비율(%)</b>	193.3	198.9	210.0	237.0	180.3
<b>자기자본비율(%)</b>	34.1	33.5	32.3	29.7	35.7
<b>영업현금흐름</b>	449.0	719.2	827.8	425.5	858.6
<b>투자현금흐름</b>	-1,172.2	-1,307.5	-1,255.5	-783.5	-403.3
<b>재무현금흐름</b>	715.2	633.5	852.6	740.6	110.2
<b>기말 현금</b>	81.8	119.1	537.8	509.5	1,103.5

\*출처: 동사 사업보고서(2020.12) 및 분기보고서(2021.09), NICE디앤비 재구성

### III. 주요 변동사항 및 향후 전망

#### 비메모리 비중 확대 등 제품 포트폴리오 다각화를 통한 실적 확대 전망

기존 업황호조 및 수요 증대와 더불어 비메모리 비중 확대, 반도체 후공정 사업 협력 계약 체결 등을 바탕으로 향후 매출 확대 및 수익구조 개선될 것으로 전망되며, 사업 강화를 위해 연결대상 법인을 2021년에 신설하며 지속적인 성장을 위해 노력하고 있다.

##### ■ 반도체 후공정 사업 협력 등 계약을 바탕으로 매출 성장세 지속 전망

최근 3개년간 우호적인 전방산업 및 고객 수요 확대에 따라 지속적인 매출 성장세를 나타냈다. 이후에도, 모바일 D램 수요 상승 등 메모리 업황 개선에 따라 반도체 제조부문과 반도체 재료부문에서 모두 매출 호조를 보이며 2021년 3분기 말 기준, 전년 매출액의 87.8%에 해당하는 4,737.3억 원을 시현하였다. 또한, 공시자료 기준, 동사의 주요 종속회사인 Hana Micron Vina Co., Ltd.가 SK하이닉스와 2021년 11월부터 2027년 12월까지의 계약기간(계약기간 만료 전 재연장 가능)으로 중장기 반도체 후공정 사업협력 및 외주 임가공 계약을 각각 체결한 바, 향후에도 지속적인 매출 외형 성장세가 이어질 것으로 전망된다.

한국투자증권(2021.11)에 따르면, 2021년 실적은 매출액 6,500억 원(+20.6% YoY), 영업이익 990억 원(+94.1% YoY), 당기순이익 250억 원을 기록할 것으로 전망하고 있다. 이와같이 전망하는 이유는 테스트 매출 비중이 커지면서 매출액영업이익률이 개선되는 등 수익성의 체질 개선이 본격화되고 있고, 메모리 어셈블리 및 비메모리 어셈블리 가동률 역시 상승하고 있기 때문이다.

이러한 흐름에 따라, 동사는 비메모리 테스트 시장 대응을 위한 생산능력 확보의 일환으로 2021년 11월 1,353억 원의 비메모리 테스트 설비투자를 진행하였으며, 2022년 1월에 반도체 테스트 설비 구축을 완료하면 패키징 사업 대비 수익성이 양호한 테스트 사업의 외형 성장과 동시에 마진 개선에 기여할 것으로 전망하고 있다.

##### ■ 사업 강화를 위한 연결대상 법인 신설

동사는 사업 강화를 위해 연결대상 법인 2곳(하나더블유엘에스, Hana Electronics Industria E Comercio Ltda)을 2021년에 신설하였다.

하나더블유엘에스는 범프사업 전문화를 위해 2021년 1월 동사로부터 물적분할한 연결대상 법인으로, 글로벌 자동차용 반도체 1위 기업 N사를 포함한 국내외 팝리스를 고객사로 두고 있다. 하나더블유엘에스는 반도체 칩 사이즈를 늘리지 않고도 고속 충전이 가능하도록 RDL을  $20\ \mu\text{m}$  이상으로 구현하는 Thick RDL 기술을 확보하고 있으며, 현재, N사의 Quick Charger IC에 적용되어 삼성전자 스마트폰 플래그십 모델에 독점으로 공급하고 있다. 또한, 하나더블유엘에스는 글로벌 자동차용 반도체 1위 업체인 N사가 향후 자율주행차 및 전기차의 보편화에 따른 자동차용 반도체의 수요가 증가함에 따라 수혜를 받을 것으로 전망되며, N사를

주요 고객사로 확보하고 있는 하나더블유엘에스의 매출에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다.

한편, Hana Electronics Industria E Comercio Ltda는 브라질 반도체 패키징 및 테스트 사업 강화를 위해 2021년 6월 신규출자한 연결대상 법인으로, 기존에 설립된 브라질 법인(HT MICRON SEMI CONDUTORES S.A., HANA INNOSYS LATIN AMERICA, LIMITED)과 함께 브라질 고객사 관리, 반도체 패키징 및 테스트 서비스를 제공할 예정이다.

## ■ 자금 조달을 위한 유상 증자 및 무상 증자 진행

동사는 2021년 12월 구 주주 배정 후 실권주 일반공모 방식으로 1,452억 원 상당의 유상증자(보통주 800만주 발행, 발행가액 18,150원)를 실시하였다. 동사는 상기 유상증자를 통해 조달된 자금을 비메모리 TEST 시장 대응을 위한 생산능력 확보를 위한 시설자금으로 1,074억 원, 패키징 공정에 투입되는 원재료 구입에 30억 원, 예비비로 344억 원을 활용할 계획이다.

또한, 동사는 2021년 12월 무상증자도 동시에 진행하며, 보통주 1주당 0.2주를 발행하였다. 이와 관련된, 배정 기준일은 납입일 2021년 12월 17일, 신주 상장일은 2022년 1월 4일이다.

## ■ 증권사 투자의견

작성기관	투자의견	목표주가	작성일
한국 투자증권	매수(유지)	29,000원	2021. 11. 15
	<ul style="list-style-type: none"> <li>2021년 실적은 매출액 6,500억 원(+20.6% YoY), 영업이익 990억 원(+94.1% YoY), 당기순이익 250억 원을 기록할 것으로 전망</li> <li>동사의 자회사 Hana Micron Vina Co., Ltd.(베트남)와 SK하이닉스와의 반도체 후공정 사업협력 및 외주 임가공계약 체결공시로 베트남 법인의 매출액은 빠르게 증가할 것으로 전망</li> <li>2027년까지 베트남 법인에 총 2,000~3,000명의 인력을 충원할 계획을 가지고 있으며, 베트남의 인건비가 국내보다 저렴하다는 점을 감안하면 10% 내외 정도의 영업이익률 될 것으로 추정</li> </ul>		
상상인증권	증장기 주가상승(유지)	21,000원	2021. 10. 15
	<ul style="list-style-type: none"> <li>2021년 하반기 본업/개별 실적은 상반기 대비 안정적 성장</li> <li>연간 200억 이상 영업이익이 예상</li> </ul>		
한화 투자증권	Not Rated	-	2021. 10. 01
	<ul style="list-style-type: none"> <li>2021년 실적은 매출액 6,302억 원(+16.8% YoY), 영업이익 996억 원(+95.3% YoY)을 기록할 것으로 전망</li> <li>삼성전자의 비메모리 투자 확대에 힘입어 동사는 2021년 8월 말 1,500억 원의 비메모리 테스트 설비투자 공시했고, 이 투자가 완료되면 테스트 사업의 매출 기준 캐파는 1,300억 원에 이를 것으로 전망</li> <li>증장기적으로 메모리 후공정으로 외형 확대를 하고, 비메모리 후공정으로 수익성 개선을 이룰 수 있어 후공정 기업 중 가장 돋보이는 성장을 나타낼 것으로 판단</li> </ul>		

## ■ 시장정보(주가 및 거래량)

[그림 7] 동사 1개년 주가 변동 현황

